

2016年3月1日

デンカ株式会社

デンカベトナム、デンカサーモフィルム（カバーテープ用フィルム）の 初出荷セレモニーを開催

デンカベトナムでは2016年3月1日に、「デンカサーモフィルム」の初出荷セレモニーを開催しました。

デンカサーモフィルムは、ICパッケージやチップコンデンサーなど、電子部品を包装するキャリアテープに使われるカバーテープ材料です。

セレモニーの当日、製品を満載したコンテナが、中国の電化精細材料（蘇州）有限公司に向けて出発しました。出席者一人ひとりが、無事故無災害の永続的な達成と事業発展を誓い合いました。

「デンカサーモフィルム」は、2015年6月のビニテープ生産開始に続くデンカベトナムの二つ目の製品となります。今後は日本の伊勢崎工場と中国蘇州の電化精細材料に続く第三の電子包材の生産拠点として、中国・東南アジア地域を中心とした旺盛な需要に応じてまいります。



セレモニー参加者



初出荷風景

以上